

研究員：陳俐妍 ly.c@capital.com.tw

前日收盤價	1,105.00 元
目標價	
3 個月	1,380.00 元
12 個月	1,380.00 元

台積電(2330 TT)

Buy

近期報告日期、評等及前日股價

10/18/2024	Buy	1,035.0
07/26/2024	Trading Buy	979.0
07/19/2024	Buy	1050.0
06/20/2024	Buy	981.0
05/23/2024	Buy	875.0

公司基本資訊

目前股本(百萬元)	259,327
市值(億元)	286,556
目前每股淨值(元)	153.86
外資持股比(%)	73.54
投信持股比(%)	1.85
董監持股比(%)	6.52
融資餘額(張)	27,410
現金股息配發率(F)(%)	33.15

產品組合



晶圓:100.00%

股價相對大盤走勢



受惠 AI 紅利成長，維持 Buy，目標價 1,380 元。

投資建議：受到 AI 相關需求強勁，台積電預計 AI 加速器業務營收在 2025 年將會持續增加 1 倍，其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦，台積電預估 2025 年 Foundry 2.0 產業將 YoY+10%。台積電憑技術領先及差異化，和 AI 客戶訂單需求佳，廣泛客戶基礎的支持下，營運將優於產業平均，2025 年將會是另一個強勁成長的一年，預估 2025 年全年營收以美元計價 YoY+24~25%。預估台積電 2025 年稅後 EPS 為 57.89 元。美國管制初步評估影響並不顯著，台積電認為還在可控範圍。台積電受惠 AI 需求成長，競爭力優於同業，維持 Buy，目標價 1,380 元(2025 年 PER24X)。

4Q24 稅後 EPS 14.45 元：4Q24 營收為 8,684.62 億元，QoQ+14.32%，接近原本預估的上緣。4Q24 出貨量為 341.8 萬片約當 12 吋晶圓，QoQ+2.60%。毛利率方面，產 4Q24 產能利用率維持高檔，雖然有電力上漲和 N3 稀釋不利毛利率，但公司持續改善成本，使台積電 4Q24 毛利率較 3Q24 增加 1.17 個百分點至 59.00%。4Q24 稅後 EPS 14.45 元。台積電累計 2024 年稅後 EPS 45.24 元。

資本支出預估 380~420 億美元：台積電預估 2025 年資本支出 380~420 億美元，YoY+27.68~+41.13%。其中先進製程 N5、N3 和 N2 製程產能的增加將佔總資本支出比重 70~80%。2024 年折舊費用為 6,627.96 億元，YoY+24.54%，較之前預期 YoY+30% 少，因為控制資本支出，預估 2025 年折舊費用 YoY+7~9%，折舊費用主要來自 N3/N2 量產及海外廠的量產。

預估 1Q25 稅後 EPS 13.43 元：台積電 1Q25 AI 相關需求持續成長，不過受智慧手機淡季效應影響，使營收受到影響。毛利率方面，受 N2 和 CoWoS 擴產的影響，及隨著海外廠產能提升，估計將影響 1Q25 毛利率約 1% 以內。預估台積電 1Q25 稅後 EPS 13.43 元。

(百萬元)	2024F	2025F	2026F	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24F	1Q25F	2Q25F	3Q25F	4Q25F
營業收入淨額	2,894,309	3,719,753	4,108,621	625,529	592,644	673,510	759,692	868,462	842,549	903,936	960,624	1,012,644
營業毛利淨額	1,624,355	2,141,796	2,331,640	331,768	314,505	358,124	439,346	512,380	489,841	521,778	551,802	578,375
營業利益	1,322,053	1,730,763	1,877,637	260,205	249,018	286,556	360,766	425,713	396,739	421,893	445,653	466,478
稅後純益	1,173,268	1,501,334	1,682,989	238,712	225,485	247,846	325,258	374,680	348,310	348,696	392,457	411,871
稅後 EPS(元)	45.24	57.89	64.90	9.21	8.70	9.56	12.54	14.45	13.43	13.45	15.13	15.88
毛利率(%)	56.12%	57.58%	56.75%	53.04%	53.07%	53.17%	57.83%	59.00%	58.14%	57.72%	57.44%	57.12%
營業利益率(%)	45.68%	46.53%	45.70%	41.60%	42.02%	42.55%	47.49%	49.02%	47.09%	46.67%	46.39%	46.07%
稅後純益率(%)	40.54%	40.36%	40.96%	38.16%	38.05%	36.80%	42.81%	43.14%	41.34%	38.58%	40.85%	40.67%
營業收入 YoY/QoQ(%)	33.89%	28.52%	10.45%	14.41%	-5.26%	13.64%	12.80%	14.32%	-2.98%	7.29%	6.27%	5.42%
稅後純益 YoY/QoQ(%)	39.93%	27.96%	12.10%	13.13%	-5.54%	9.92%	31.23%	15.19%	-7.04%	0.11%	12.55%	4.95%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；稅後 EPS 以股本 2,593.27 億元計算。

台積電 ESG 治理：

台積電公司實現永續發展的未來。為改善人類生活困境，實現永續與公平的未來，聯合國提出「2030 永續發展議程」並制定 17 個永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)，呼籲全球政府及企業採取行動，共同消除貧困、改善健康與教育、減少不平等、促進多元共融、刺激經濟成長，同時因應氣候變化與水資源貧瘠、戮力保護海洋及森林的生物多樣性。

台積電公司採用 GRI 與聯合國全球盟約共同發布的《SDGs 報導的實務指引》，鑑別出具相關性的 9 項 SDGs 清楚說明每個 SDG 的細項目標，並制定可量化的民國 119 年長期目標，以「規畫、承諾、行動、進展、合作」五大面向管理台積電公司的永續行動，透過定期檢視長期目標進展，向外界說明台積電公司具體的行動方案與成效，以及鏈結利害關係人的夥伴力量。此外，設定紅、黃、綠燈等級，定期檢核民國 119 年長期永續目標的進展與達標程度，動態審視目標合適性並評估新增或刪除項目，確保行動符合趨勢，持續實踐 SDGs。

民國 112 年，台積電公司承諾 57 項呼應 SDGs 的長期目標，其中新增 5 項目標，包含提升全球在地採購間接原物料比例、廢棄物回收率、要求第一階供應商訂定多元共融政策、減少供應商碳排放量及推動女高中生 STEM 探索活動，從台積電公司自身出發，延伸價值鏈影響力。與民國 111 年相比，71% 目標 (37 個) 持續進步且達成年度目標，屬於綠燈等級的正向趨勢；29% 目標 (15 個) 為負向趨勢，其中「把關員工健康與壓力、稽核供應商負責任礦產盡職調查、失能傷害頻率、事件發生千人率、供應商環保安全衛生訓練、在地供應商參加台灣持續改善競賽」6 項目標績效雖低於前一年度，仍超越設定的年度目標，屬於黃燈等級，而「所有製程皆不使用含大於 4 個全氟碳鏈的全氟烷基物質、再生能源使用率、NMP 替代率」雖未達年度目標，仍超越去年績效，亦屬於黃燈等級；「失能傷害嚴重率、晶圓委外廢棄物處理量、單位產品空氣汙染排放量、單位產品溫室氣體排放量、單位產品用水量、製程技術效能提升」6 項目標則被定義為紅燈等級，績效未優於前一年度且未達年度設定目標。永續風險不斷攀升的年代，績效追蹤與透明揭露是 SDGs 治理的基礎，台積電公司據此實踐承諾並進一步挖掘精進機會、投入資源、調整行動，持續深化永續韌性。

N3/N5 需求強勁，台積電 4Q24 營收 8,684.62 億元，QoQ+14.32%，稅後淨利 3,746.80 億元，QoQ+15.19%，稅後 EPS 14.45 元：

台積電 4Q24 營收為 8,684.62 億元，QoQ+14.32%，接近原本預估的上緣。台積電原預估 4Q24 營收將約 261~269 億美元，QoQ+11.04%~+14.45%，中間值+12.75%。當時是以新台幣兌美元 32.0 基礎假設，新台幣營收將為 8,352~8,608 億美元，QoQ+11.62%~+13.31%。台積電 4Q24 季底匯率以 32.304 元兌換 1 美元計算，較 3Q24 的 32.32 元相近。台積電 4Q24 出貨量為 341.8 萬片約當 12 吋晶圓，較 3Q24 的 333.8 萬片約當 12 吋晶圓出貨量 QoQ+2.40%。

4Q24 在製程方面，N3 佔營收比重較 3Q24 的 20% 增加為 26%，N5 佔營收比重較 3Q24 的 32% 增加，為 34%(HPC)，N7 佔營收比重下滑至 14%，N16 製程佔營收比 7%，N28 貢獻營收佔 6%。N7 製程及更先進的製程已佔台積

電 wafer 營收 74%。

4Q24 各產品線僅 Internet of Things 和 consumer 衰退，因 3Q24 客戶已先拉貨，其餘皆呈現成長，應用端以 High-performance computing 相關產品成長最多，QoQ+19%，佔營收比重為 53%；其次為 Smartphone 相關產品，QoQ+17%，佔營收比重為 35%。Internet of Things 相關產品，QoQ-15%，佔營收比重為 5%；Automotive 相關產品，QoQ+6%，佔營收比重 4%；Digital Consumer Electronics 相關產品，QoQ-6%，佔營收比重為 1%；others 佔營收比重 2%，QoQ+2%。

毛利率方面，4Q24 產能利用率維持高檔，雖然有電力上漲和 N3 稀釋不利毛利率，但公司持續改善成本，使台積電 4Q24 毛利率較 3Q24 增加 1.17 個百分點至 59.00%，營業費用較 3Q24 增加 72.6 億元達 863.84 元，不過整體營業利益率上揚至 49.02%。毛利率達到原先預估 57.0~59.0% 高檔，營業利益率則略優於 46.5~48.5% 預估，業外主要是來自利息的增加，利息利益約 217.5 億元，台積電 4Q24 稅後淨利 3,746.80 億元，QoQ+15.19%，稅後 EPS 14.45 元。

台積電 2024 年營收為 2.89 兆元，YoY+33.89%，毛利率 56.12%，主要來自 2024 年產能利用率高於 2023 年，營益率 45.68%，歸屬母公司稅後淨利 1.12 兆元，YoY+39.93%，稅後 EPS 45.25 元。

表一、台積電對各平台營收比重

項目	4Q24	3Q24	2Q24	1Q24
High Performance Computing	53%	51%	52%	46%
Smartphone	35%	34%	33%	38%
Internet of Things	5%	7%	6%	6%
Automotive	4%	5%	5%	6%
Digital Consumer Electronics	1%	1%	2%	2%
Others	2%	2%	2%	2%

資料來源：台積電，群益預估彙整

台積電預估 2025 年資本支出 380~420 億美元，YoY+27.68~+41.13%：

台積電 2024 年資本支出 297.60 億美元，較 2023 年資本支出 304.48 億美元，YoY-2.26%。AI 需求很強和海外擴產，台積電預估 2025 年資本支出 380~420 億美元，YoY+27.68~+41.13%。其中先進製程 N5、N3 和 N2 製程產能的增加將佔總資本支出比重 70%。除先進製程新產能持續投資外，10~20% 左右將會使用在特殊製程的部份，10~20% 將投資在後段封裝、測試、光罩 mask 製作及其他項目。

台積電自 2019 年使用 EUV 以來，2019~2023 年 EUV 機台數量成長 10 倍，佔全球整體 EUV 數量 56%。台積電技術論壇指出 2020~2024 年先進製程產能年複合成長率(CAGR)25%，其中，受惠 HPC 與手機需求強勁，2024 年 N3 產能是 2023 年的 3 倍，且除先進製程，台積電也積極擴充特殊製程，預估 2020~2024 年特殊製程 CAGR 達 10%，佔 N16 以上製程的比重從 61% 提升至 67%。

2025 年 1 月 17 日

台積電 2019 年至 2023 年資本支出 1,288 億美元，主要是因應 5G、高效能運算、Smartphone 與車用電子等應用，長期動能強勁，將支持客戶需求。台積電表示資本支出的規畫，是由多元產業的大客戶與大趨勢因素所帶動，台積電投入的年度資本支出是基於對未來數年的成長預期所規畫，主要考量四大原則，包括技術領先、彈性並反應需求的製造能力、保有客戶信任，以及獲取適當的報酬。台積電為保持先進製程技術領先，亦積極衝刺先進封裝。台積電預期 5G 與高效能運算 HPC 應用市場為長期成長動能，將驅動台積電 2024 年至 2029 年營收年複合成長率將達 20% 的目標。台積電也預期長期毛利率和 ROE 目標為 53% 和 25% 以上。台積電這 2 年增加海外廠，大都是合資，且要看當地政府補助的金額，人員和廠房工程進度掌握度低於台灣，相關變數大，因此未來資本支出的變化將會增加。以資本密集度來看，過去三年中最高的是 2021 年超過 50% 接下來是 47% 和 43%，2024 年 33%，預計 2025 年為 35%，期望未來幾年資本密集度維持在 30% 左右。

台積電國內擴產計畫及進度方面，目前先進製程正聚焦擴充 N3 產能、興建 N2 產能，同時針對特殊應用也會增加些許成熟製程產能。都會留在台灣，未來包括 A16 等先進製程的大量產能，也會在台灣，不過目前尚在研發階段。N2 生產基地落腳竹科寶山二期 Fab 20 超大型晶圓廠，為台積電 N2 製程的主要重鎮，Fab20 2024 年開始風險性試產，2025 年量產，同時第二期正在興建中，預期將在第一期量產後逐步開始進入風險性試產及量產。該廠區為四期規畫，後續將擴至中科，共計有六期的工程。2025/2026 年後也會加入高雄廠 Fab22 生產，擴充 N2，高雄在原本兩座廠的一期規劃基礎上，考慮再增加一個據點，最快 2026 年量產。和南科廠互相支援，南科 Fab 18 廠 N3 邁入量產及後續擴充。中科二期則視需求狀況，預定在 2027 年評估 N2 或 A16 製程規劃。台中 AP5 與嘉義 AP7 兩個封裝廠，則分別生產 CoWoS、SoIC 與 CoWoS。

台積電 2024 年折舊費用為 6,627.96 億元，較 2023 年 5321.91 億元，YoY+24.54%，較之前預期 YoY+30% 少，因為控制資本支出，折舊費用主要來自 N3 量產，預估 2025 年折舊費用 YoY+7~9%，折舊費用主要來自 N3/N2 量產及海外廠的量產。折舊增加雖會影響毛利率，但毛利率決定的因素很複雜，包括成本、價格、匯率、產能利用率以及先進製程的量產等。台積電積極改善成本，抵銷所有不利的因素。

台積電拓展全球生產據點，以維持競爭力和服務客戶，目前海外廠皆照原先進度進行中：

過去追求全球化布局，如今為安全戰略考量轉為區域化，美國、日本、歐洲及中國大陸等各國政府都歡迎廠商前往當地設廠，一個全球化、有效率供應系統時代已經過去，全球化轉變為地區化，讓供應鏈管理益形重要，成本也會急速增加。台積電將與客戶緊密合作，降低風險。

台積電日本熊本 Fab 23 廠在 02/24/2024 舉行開工典禮，主要製程為 N22/28 和 N12/N16，JASM 晶圓廠初期採用 22/28nm 製程提供專業積體電路製造服務，索尼半導體解決方案公司計畫投資約 5 億美金，取得 JASM 不超過 20% 之股權，日本 JASM 晶圓廠 2023 年完工，設備在 10/2023 移入，04/2024 投產並自 12/2024 起出貨。資本支出共 86 億美元，月產能 55K 片 12 吋晶圓。

2025 年 1 月 17 日

JASM 第二座晶圓廠的土地準備工作已經開始，計畫於 2025 年開始興建，計畫在 2027 年底開始營運，此兩座晶圓廠在日本政府的大力支持下，JASM 的總投資金額將超過 200 億美元。JASM 兩座晶圓廠每月總產能預計超過 100K 片 12 吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算 HPC 相關應用提供 N40、N22/28、N12/16 和 N6/7 的製程技術。產能規劃可能會依據客戶需求進一步調整，熊本晶圓廠預計將直接創造總計超過 3,400 個高科技專業工作機會。透過這項投資，台積電、索尼半導體解決方案公司 (Sony Semiconductor Solutions Corporation, SSS)、電裝株式會社 (DENSO Corporation)，以及豐田汽車公司 (Toyota Motor Corporation) 將分別持有約 86.5%、6.0%、5.5% 和 2.0% 的 JASM 股權。

美國商務部和 TSMC Arizona 已簽署一份不具約束力的初步備忘錄 (preliminary memorandum of terms, PMT)，基於《晶片與科學法》(CHIPS and Science Act)，TSMC Arizona 將獲得最高可達 66 億美元的直接補助。台積電亦宣布計畫在 TSMC Arizona 設立第 3 座晶圓廠，以透過在美國最先進的半導體製程技術來滿足強勁的客戶需求。除 66 億美元直接補助，初步備忘錄 (PMT) 亦提議向台積電提供最高可達 50 億美元的貸款。台積電亦計畫向美國財政部就 TSMC Arizona 資本支出中符合條件的部分，申請最高可達 25% 的投資稅收抵免。所以台積電同意擴大美國廠規劃中的投資額，再加碼 250 億美元，總額攀抵 650 億美元，2030 年前將在亞利桑那興建第 3 座晶圓廠。

台積電美國目前第一座廠，N4 製程工程晶圓生產，結果令人非常滿意，量產時間為 1H25。第一期產能為 20K/月，預計有望在 2026 年開始生產 N3 製程技術。兩期工程完工後將合計年產超過 600K 片晶圓 (50K 片/月)。第二座晶圓廠將生產採下一代奈米片 (Nanosheet) 電晶體結構的 N2 製程，預計於 2028 年開始生產；第 3 座晶圓廠則預計將在 2030 年採用 N2 或更先進的製程技術進行晶片生產。台積電於美國提供最先進的半導體技術量產，每一座晶圓廠的潔淨室面積，大約為一般標準型邏輯工廠的 2 倍。未來視客戶需求，N3/N2/A16 都將有機會導入，不過最先進製程仍以台灣為主，因為台灣的研發人員多，海外的研發人員仍缺。

08/20/2024 台積電德國 - 歐洲半導體製造公司 (European Semiconductor Manufacturing Company, ESMC) 廠於德勒斯登舉行動土典禮。2023 年台積電、羅伯特博世 (Robert Bosch GmbH)、英飛凌 (Infineon Technologies AG) 和恩智浦半導體 (NXP Semiconductors N.V.) 宣布將共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司 (European Semiconductor Manufacturing Company, ESMC)。此計畫依據《歐洲晶片法案》(European Chips Act) 的框架制，合資公司將由台積電持有 70% 股權，博世、英飛凌和恩智浦則各持有 10% 股權。透過股權注資、借債，以及在歐盟和德國政府的大力支持下，總計投資金額預估超過 100 億歐元，該晶圓廠將由台積電營運。計畫興建的晶圓廠預計採用台積電 N28/22 平面互補金屬氧化物半導體 (CMOS)，以及 N16/12 鰭式場效電晶體 (FinFET) 製程技術，月產能約 40K 片 12 吋晶圓，將支援汽車和工業市場中快速成長的未來產能需求。藉由先進的 FinFET 技術，將能進一步強化歐洲半導體製造生態系統，且創造約 2,000 個直接的高科技專業工作機會。ESMC 在 4Q24 開始興建晶圓廠，並於 2027 年底開始生產。ESMC 建設的無塵室面積約 4.5 萬平方公尺。台積電赴德國設廠，除提高歐洲半導體製造全球市佔率，未來台積電德國廠每年將生產約 480K 片

12 吋晶圓。

05/23/2024 台積電宣布，美國商務部近日已核發「經認證終端用戶」(VEU) 授權予台積電(南京)有限公司。這項正式的 VEU 授權取代之前商務部自 10/2022 以來核發的臨時書面授權。確認美國出口管制法規涉及的物品和服務得以長期持續提供予台積電南京廠，供應商不需取得個別許可證，南京廠可望維持現狀。台積電中國南京 16 廠也持續擴充 N28 產能，滿足客戶需求。

海外晶圓廠的起始成本高於台積電在台灣的晶圓廠，因海外晶圓廠規模較小，整體供應鏈的成本較高，且與台灣成熟的半導體生態系相比，海外半導體生態系仍處於早期階段。台積電在美國亞利桑那州和日本熊本都將分階段建設多座晶圓廠，因此當第一階段晶圓廠的獲利能力開始提高時，第二階段晶圓廠就會開始建設，進而導致未來 3~5 年內每年持續稀釋 2~3% 毛利率。

但公司目標是透過管理達最小化成本差距，彈性定價策略，和客戶分擔成本，及利用地域上的靈活性，繼續與各國政府密切溝通合作，以降低成本。因此，即便在台灣以外增加產能，相信長期毛利率達 53% 以上仍是可實現，具持續性且健全的股東權益報酬率(ROE)能優於 25%，同時為股東帶來盈利增長。目前來看，各廠都符合原先規劃的進度。台積電勢必會增加海外廠的投資，雖然成本高於台灣，除地緣政治的因素外，台灣本身的土地和水電等基礎條件也受到限制。

表二、台積電新廠規劃

晶圓廠	期數	製程	備註
南科 Fab 14	P8	特殊製程	
南科 Fab 18	P4~P9	N5/N4、N3	
竹科 Fab 20	P1~P6	N2/A16	2025 年量產
高雄 Fab 22	P1~P2	N2	2025 年量產
美國 Fab 21	P1~P2	N5/N4、N3/N2	1H25 量產
日本熊本廠 JASM Fab 23	P1~P2	N28//N22、N16/N12	4Q24 量產
德國	P1~P2	N28//N22	2027 年量產

資料來源：台積電，群益預估彙整

台積電 N2 製程將採用 GAA 架構，預計 4Q25 量產，2026 年貢獻營收：

台積電 N3 和 N3E 製程技術採用 TSMC FinFlex™ 架構，2H23 明顯營收貢獻，貢獻 2023 年 wafer 營收 6%。N3 家族中 N3P 則會在 2H24 量產。相較於 N3E，N3P 在相同 power 下，速度增快 5%；在相同速度下，功耗降低 5~10%，晶片密度增加 4%。另外，N3X 則著重於效能與最大時脈頻率以支援高效能運算應用，相較於 N3P，在驅動電壓 1.2 伏特下，速度增快 5%，並擁有相同的晶片密度提升幅度，預計 2025 年進入量產，此一製程相當於 Intel 的 18A 製程。而 N3AE 是提供以 N3E 為基礎的汽車製程設計套件，在 2023 年推出，讓車用客戶能提早採用 N3 技術設計汽車應用產品，希望能在 2025 年即時採用屆時已全面通過驗證的 N3A 製程。N3 家族貢獻 2024 年營收 18%。台

2025 年 1 月 17 日

積電也宣佈推出先進 N4C 技術以因應更廣泛的應用，N4C 延續 N4P 技術，晶粒成本降低高達 8.5% 且採用門檻低，預計於 2025 年量產。N4C 提供具有面積效益的基礎 矽智財及設計法則，皆與廣被採用的 N4P 完全相容，因此客戶可以輕鬆移轉到 N4C，晶粒尺寸縮小亦提高良率，為強調價值為主的產品提供具有成本效益的選擇，以升級到下一個先進技術。

台積電 N2 計畫 4Q25 量產，Tape-out 數量更勝 N3；不過因複雜度提高、Cycle Time 長，因此 2026 年才有較明顯營收貢獻。N2P 和 N2X 則計畫 2026 年推出。台積電 N2 採用採用 GAAFET 奈米片 (Nanosheet) 架構，奈米片電晶體效能已超過台積電技術目標 80%，同時具優異的能源效率和更低的工作電壓 (Vmin)。N2 製程技術平台也會導入背面電軌 (backside power rail) 設計，可為其基線技術提供額外的速度和密度提升。背面電軌設計最適合用於 HPC 產品，將於 2H25 推出，2026 年量產。透過減少壓降 (IR drop) 和訊號電阻-電容延遲 (signal RC delays)，使速度提升超過 10~12%。且晶圓正面擁有更多的布線空間，使邏輯面積可減少 10~15%。相較 N3E，在相同功率下，速度提升 10~15%；在相同速度下，功耗降低 25~30%。此外，最重要的就是 N2 以下，打得是材料戰。台積電將繼續在 N2 以下探索電晶體 transistor 架構，並利用 2D 材料和碳奈米管等新材料。在 2D 材料中，鈹接觸二硫化鉬 (MoS2) 裝置實現創紀錄的低接觸電阻，比過去 2D 材料提報的數據好上 5 倍，並產生高通態電流。目前 HPC 和 Smartphone 客戶皆有，除行動運算基準版本之外，N2 技術平台還包括一個高效能變體，以及完整的小晶片整合解決方案，N2P 將會在 2H26 量產。

台積電 A16™ 是採奈米片 (Nanosheet) 電晶體技術，並採用超級電軌技術 (Super Power Rail, SPR)。台積電 SPR 是具有獨創性、領先業界的背面供電解決方案。SPR 將供電線路移到晶圓背面，以在晶圓正面釋放出更多訊號線路佈局空間，來提升邏輯密度和效能。SPR 也能大幅度降低 IR drop，進而提升供電效率。更重要公司獨特 backside contact 技術能夠維持與傳統正面供電下相同的 閘極密度 (Gate Density)、布局版框尺寸 (Layout Footprint) 和元件寬度調節的彈性，因此可以提供最佳的密度和速度上的優勢，這也是業界首創的技術。A16 特別適用於具有複雜訊號線路和高密度供電線路的高效能運算 HPC 產品。相對 N2P，A16 在相同電壓 Vdd 下，速度增快 8~10%，或在相同速度下，功耗降低 15~20%，晶片密度 (Chip Density) 提升高達 1.07~1.10 倍，以支援資料中心產品，預計 2H26 量產。

台積電在 1.4nm (A14) 製程早已在研發之中，N2 則將如期於 2025 年量產，目前台積電尚未透露 A14 的量產 (HVM) 時間和具體參數。台積電預告到 2030 年將提供封裝超過一兆個電晶體的下一代晶片封裝的工藝藍圖。巨大的電晶體數量將透過先進的多晶片組 3D 封裝實現。但台積電認為封裝密度和原始電晶體密度必須同步提升，因此台積電的目標還包括提高單片晶片的複雜性，最終在單個晶片上實現 2000 億個電晶體的設計。台積電正致力於 2nm 級 N2 和 N2P 生產，而 1.4nm 級 A14 和 1nm 級 A10 預計將於 2030 年完成。

表三、各製程比較

Node	N3 vs N5	N3E vs N5	N3P vs N3E	N3X vs N3P	N2 vs N3E	N2P vs N3E	N2P vs N2	A16 vs N2P
Power	-25% -30%	-34%	-5% -10%	-7%** *	-25% -30%	-30% -40%	-5% -10%	-15% -20%
Performance	+10% +15%	+18%	+5%	+5% Fmax @1.2V **	+10% +15%	+15% +20%	+5 +10%	+8% +10%
Density*	-	1.3x	1.04x	1.10x* **	1.15x	1.15x		1.07x 1.10x
HVM	4Q22	4Q23	2H24	2H25	2H25	2H26	2H26	2H26

資料來源：台積電，群益預估彙整

CoWoS 需求還是很強，先進封裝佔 2024 年營收 8%，預估 2025 年將佔營收 10%：

台積電 2.5D CoWoS 可以分成 CoWoS-S、CoWoS-R、CoWoS-L，主要差別在於中介層使用的材料以及可封裝的 HBM 數。目前市面上主流為 CoWoS-S，是用 Si interposer。CoWoS-R 則是利用 InFO 中的 RDL 技術將小晶片互連，特別應用在 HBM 和 SoC 異質整合中。RDL 中介層由聚合物和銅線組成，具有相對機械柔性。封裝擴大其尺寸以滿足更複雜的功能需求。CoWoS-L 是在矽中介層中加入主動元件 LSI，可堆疊多達 12 顆 HBM3，由於加入 Si bridge，設計較為複雜，價格當然相對較高。

進入 N3 以後，客戶皆用 Chiplet 設計，就必須使用先進封裝，台積電先前預期 2022~2026 年 CoWoS 產能年複合成長率超過 60%。2024 年 CoWoS 產能可望較原先預期倍增再增加，預估 2025 年相關產能增加幅度也會超過倍增，台積電也有與後段專業封測代工廠 OSAT 持續合作布局先進封裝，因應客戶強勁需求，這樣可以銷售更多台積電的 wafer。

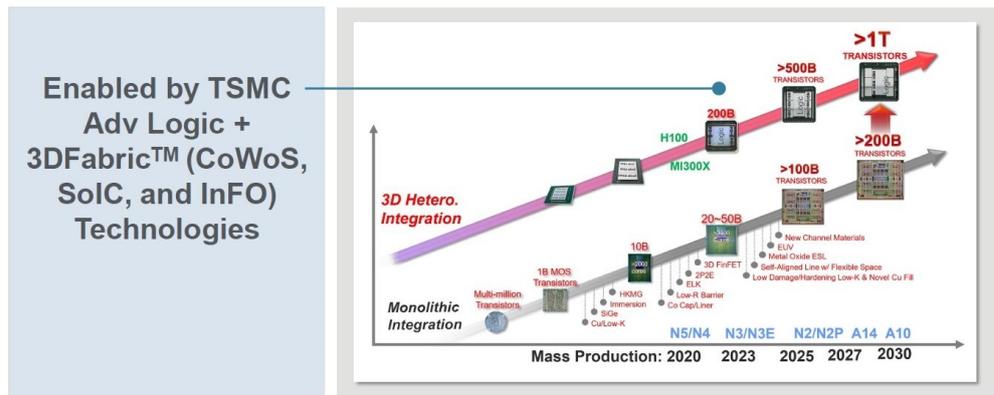
台積電先進封裝產能主要客戶 NVIDIA 約佔 50% 產能以上，AMD(AMD US) 緊追其後，博通(AVGO US)、亞馬遜(AWS US)、Marvell(MRVL US)均表態積極採用先進封裝製程。台積電竹南先進封裝廠(AP6)啟用至今一年，隨 AP6C 機台陸續到位，已成為全台最大 CoWoS 基地，台積電增添 CoWoS 相關設備 2024 已到位，並要求設備廠增派工程師全面進駐龍潭 AP3、竹南 AP6、中科 AP5 等廠，除竹南廠 AP6C，中科廠原只進行後段 oS，也將陸續轉成 CoW 製程，嘉義則在整地階段，進度將超前銅鑼。CoWoS 在 2024 年底達到近 40K/月，較 2023 年 17K/月，倍數翻揚，先進封裝產能供不應求更將延續至 2025 年，預估台積電 2025 年年產能將達 700K 以上，希望 2025 年吃緊狀況可逐步緩解，2026 年供給需求可達到平衡。

後段封測的毛利率在過去 2 年改善，除達到經濟規模，公司也努力降低成本，仍低於公司的平均。整體先進封裝 2024 年營收 8%，預估 2025 年先進封裝整體的營收將佔台積電營收 10% 以上。

FOPLP 封裝台積電正在研究，但目前尚未成熟，認為至少要 3 年後才有機會。目前台積電客戶最大是 die size 是 5 x reticle size，當 die size >10x reticle size 才有機會引入 FOPLP，台積電屆時也會準備好。

圖一、TSMC 系統整合晶片 Roadmap

System Scaling Innovation



資料來源：Applied Materials，群益預估彙整

2025 年完成支援小型插拔式連接器的 COUPE 驗證，2026 年整合 CPO 至 CoWoS，較明顯的營收貢獻也在 2026 年中：

台積電表示單靠電晶體驅動技術效能提升已經不夠，需靠 3D IC 先進封裝提升晶片效能。台積電成立 3D Fabric 先進封裝平台，即是繼提升，密度、提升效片運算，因應高效能運算 HPC 晶片需求透過先進封裝的解決方案提升晶片運算效能。為滿足客戶對 SoIC 和其他 TSMC 3DFabric™ 系統整合服務的需求，SOIC 第一個產品將為 HPC。3DIC 及先進封裝為台積電研發重要的兩隻腳之一，未來拓展至少是 5~10 年、甚至 10 年後，包括光學運算(CPO) 是很重要的一部分，台積電研發經費約 4 分之 3 在先進製程及封裝，4 分之 1 在特殊製程，未來有多少案子就會投入多少，毛利率低於晶圓代工，不過未來成長將優於公司整體的成長。2024 年北美技術論壇揭示最新先進封裝及 3D IC 技術，除推出系統級晶圓(SoW)技術，也預計 2026 年整合 CoWoS 封裝成為共同封裝光學元件(CPO)，將光連結直接導入封裝中。

為支援 AI 熱潮帶來的數據傳輸爆炸性成長，台積電正研發緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術，使用 SoIC-X 晶片堆疊技術，將電子裸晶(die)堆疊在光子裸晶之上，相較傳統的堆疊方式，能夠為裸晶對裸晶介面，提供最低的電阻及更高的能源效率。台積電預計 2025 年完成支援小型插拔式連接器的 COUPE 驗證，2026 年將光連結直接導入封裝中，整合共同封裝光學元件(CPO)和 CoWoS 封裝。台積電預估要再 1~1.5 年左右才能量產，在 2026 年才會有較明顯的量。

台積電針對系統級晶圓技術(System in Package, SiP)提供新選項，讓 12 吋晶圓能夠容納大量的晶粒，提供更多的運算能力，大幅減少資料中心的使用空間，並將每瓦效能提升好幾個數量級。台積電已量產的首款 SoW 產品採

2025 年 1 月 17 日

用以邏輯晶片為主的整合型扇出(InFO)技術，而採用 CoWoS 技術的晶片堆疊版本預計於 2027 年準備就緒，能夠整合 SoIC、HBM 及其他元件，打造一個強大且運算能力媲美資料中心伺服器機架或甚至整台伺服器的晶圓級系統。

車用先進封裝方面，台積電繼 2023 年推出支援車用客戶及早採用的 N3AE 製程後，也藉由整合先進晶片與封裝來持續滿足車用客戶對更高運算能力的需求。台積電正在研發 InFO-oS 及 CoWoS-R 解決方案，支援先進駕駛輔助系統(ADAS)、車輛控制及中控電腦等應用，預計 4Q25 完成 AEC-Q100 第二級驗證。

智慧型手機淡季，預估台積電 1Q25 營收 8,425.49 億元，QoQ-2.98%，稅後淨利 3,483.10 億元，QoQ-7.04%，稅後 EPS 13.43 元：

台積電 4Q24 Days of inventory(DOI)較 3Q24 減少 7 天達 80 天，主要是因為 N3/N5 wafer 在 4Q24 出貨增加。台積電 1Q25 AI 相關需求持續成長，不過受智慧手機淡季效應影響，使營收受到影響。CPU、GPU 和 AI 加速器等執行訓練(training)和推論(inference)功能的 AI 處理器的相關晶片，不包括網路邊緣或裝置內。AI 營收貢獻將在 2025 年增加 1 倍以上，2023 年佔台積電營收 6%，約 42 億美元，2024 年佔營收比重約 15%，達 135 億美元，2024~2029 年，台積電預計將以 45% 的年複合成長率增加，到 2028 年將佔台積電營收超過 20%。毛利率方面，台積電預估 1Q25 毛利率將約 57%~59%，以中間值計，4Q24 下滑約 1 個百分點，主要是 N2 和 CoWoS 擴產的影響，及海外廠產能提升將影響 1% 以內，海外廠產能增加將增加全年毛利率 2~3 個百分點。預估台積電 1Q25 營收 8,425.49 億元，QoQ-2.98%，稅後淨利 3,483.10 億元，QoQ-7.04%，稅後 EPS 13.43 元。

預估台積電 2025 年營收 3.72 兆元，YoY+28.52%，稅後淨利 1.50 兆元，YoY+27.96%，稅後 EPS 57.89 元：

台積電 N3 和 N5 需求強勁，2024 年因為 AI、智慧手機對於先進製程需求大，預期 2024 年不包含記憶體在內的所有半導體市場將 YoY+10%，維持不變。值得注意的是，台積電將晶圓代工 Foundry 產業重新定義為「晶圓代工 2.0」，包括封裝、測試、光罩製造等，以及所有 IDM，但不包括記憶體製造。新定義能更好地反映台積電晶圓代工和封測營收的未來成長，但強調台積電將只專注於最先進的後端封測技術，先進封測技術是幫助客戶在 leading edge 產品上領先。在這個新定義下，2023 年晶圓代工產業的規模接近 2,500 億美元，若用之前定義約 1,150 億美元。在新定義下，台積電 2023 年市佔率為 28%(原定義下台積電市佔率>60%)，2024 年晶圓代工產業 YoY+6%(原先預期 10%)。

台積電將 AI 產品定義為 AI GPU、AI ASIC 和用於 AI 訓練和推理的資料中心 HBM 控制等。台積電 2023 年 HPC 需求成長率已超越手機，隨著 AI 發展更加明確，2024 年 AI 加速器業務佔台積電總收入約 14~16%，儘管 2024 年 AI 加速器業務收入已經成長超過 2 倍，但預計 2025 年仍將持續成長 1 倍。台積電預計，以 2024 年較高的基礎計算，2024~2029 年 AI 加速器業務收入的複合年增長率(GAGR)將接近 45%。隨著 AI 相關需求的強勁增長，台積電的技術平台價值正在提升。台積電以最有效和最具成本效益的方式，大規模提供最先進的製程和封裝技術，以滿足長期市場需求的結構性增長。台積電 2024 年 HPC 佔營收比重達 51%，YoY+58%，AI 加速器將成

2025 年 1 月 17 日

為其高效能運算平台(HPC)增長最強勁的驅動力，並且是未來幾年台積電整體營收增量增長的最大貢獻者。

受到 AI 相關需求強勁，預計 AI 加速器業務營收在 2025 年將會持續增加 1 倍，其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子的溫和復甦，台積電預估 2025 年 Foundry 2.0 產業(台積電定義為所有邏輯晶圓製造、封裝、測試、光罩製造和其他)將 YoY+10%。台積電憑技術領先及差異化，和 AI 客戶訂單需求佳，廣泛客戶基礎的支持下，營運將優於產業平均，2025 年將會是另一個強勁成長的一年，預估全年營收以美元計價 YoY+24~25%。

台積電毛利率仍低於客戶，尤其很難達到全球最大 AI 晶片供應商的毛利率水準，晶圓代工是資本密集型企業，需要非常高的毛利率才能生存並持續健康的成長，這也是公司的定價策略之一。價值銷售策略將持續進行，同一個製程，HPC、手機不同客戶，價格會不一樣。各製程價格也不同。製程升級或優化，價格也會提高，如 N3E 售價高過 N3B，先進製程增加，台積電 ASP 隨之提升，產能利用率提高和改善成本將會抵消不利的因素。

2025 年毛利率有利因素：1)隨著 N3 量產，稀釋效應預計將逐漸減少。2)預計 2025 年整體產能利用率將適度提高。不利因素：1)海外晶圓廠由於初期規模較小，放量和成本較高，海外晶圓廠的獲利能力預計將低於台灣的晶圓廠。隨著時間推移，海外晶圓廠的獲利能力將逐漸提高。台積電預計海外晶圓廠將稀釋毛利率約 2~3%。1Q25 影響不到 1 個百分點，但隨著熊本和亞利桑那州晶圓廠的擴產，全年的影響將更加明顯。2)電費方面，台積電在 2022 年、2023 年和 2024 年分別面臨 15%、17%和 25% 的電價漲幅。換句話說，過去幾年電價幾乎翻倍。台積電預計 2024 年上漲電價和其他通貨膨脹成本將影響台積電至少 1%的毛利率。3)N2 的量產成本和 N5 產能轉換為 N3 產能的成本預計將影響毛利率約 1%。4)匯率也可能是一個影響因素，但無法控制。

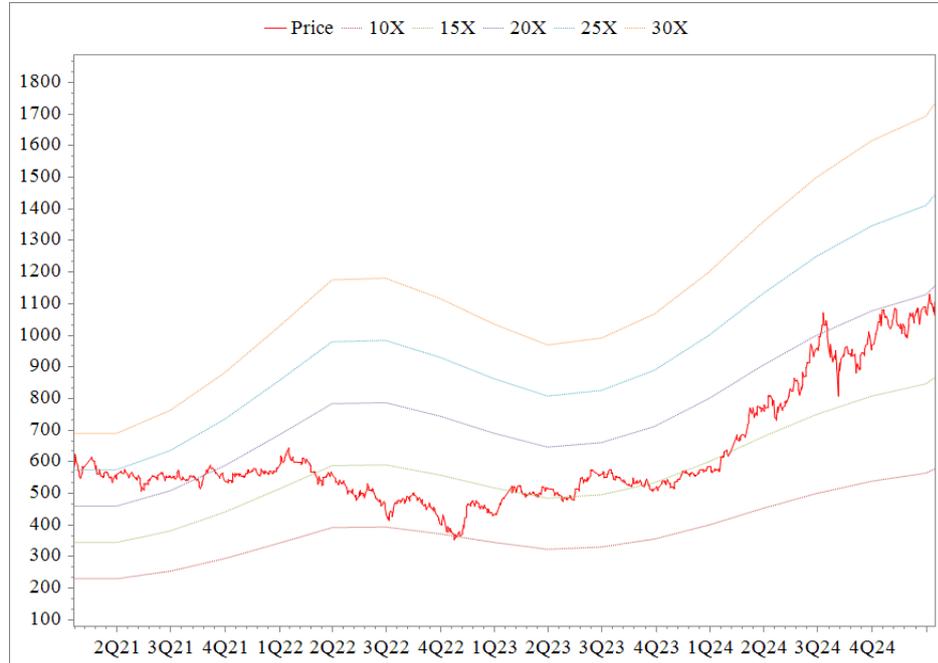
美國管制初步評估影響並不顯著，台積電認為還在可控範圍，主要影響在客戶端。此外台積電正在為受限制的客戶申請特殊許可證，來自汽車產業、加密貨幣挖礦等產業。挖礦機所使用 ASIC 晶片面積與真正 AI 晶片面積尺寸差別很大。涉及 AI 相關晶片則不會幫忙申請。台積電 2025 年成長動能來自 AI 及 N5/N3 製程和先進封裝 CoWoS 等營收貢獻上揚，預估台積電 2025 年營收 3.72 兆元，YoY+28.52%，稅後淨利 1.50 兆元，YoY+27.96%，稅後 EPS 57.89 元。預估 2025 年所得稅率 16~17%。

表四、台積電對半導體市場成長預測(美元計價)

項目	2024 年(07/18/2024) 改變晶圓代工的定義	2024 年 (01/16/2025)	2025 年 (01/16/2025)
晶圓代工	~10%(含封測)	+6%	+10%
台積電(美元營收)	~30%	33%	~25%

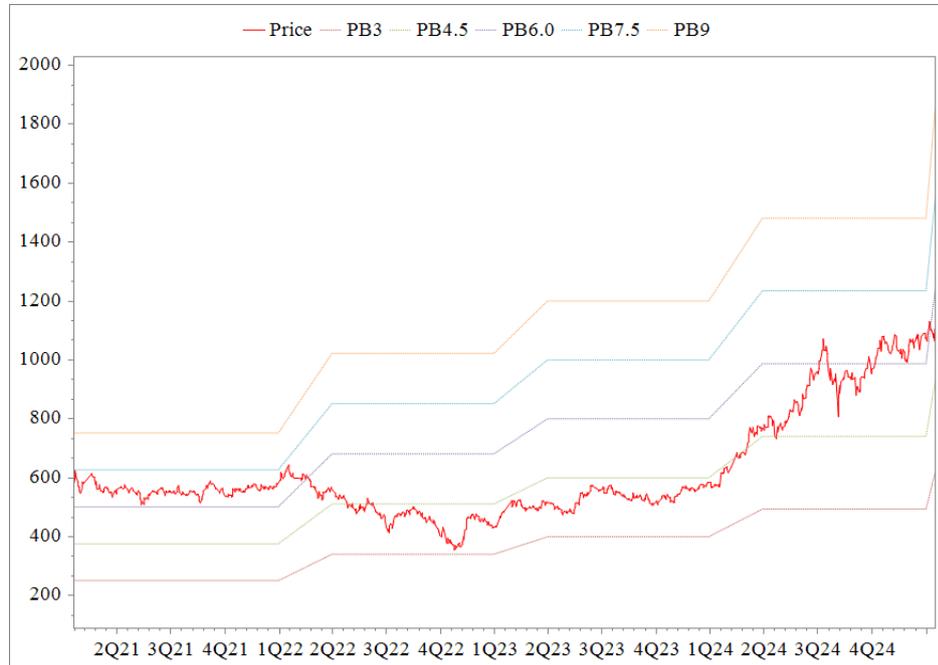
資料來源：台積電，群益預估彙整

Forward PE Band



資料來源：CMoney，群益預估彙整

Forward PB Band



資料來源：CMoney，群益預估彙整

資產負債表

(百萬元)	2022	2023	2024F	2025F	2026F
資產總計	4,964,779	5,532,371	6,691,938	9,234,972	11,426,609
流動資產	2,052,897	2,194,033	3,088,352	3,779,062	3,358,331
現金及約當現金	1,342,814	1,465,428	2,127,627	2,510,282	2,226,621
應收帳款及票據	231,340	201,938	272,088	360,023	444,045
存貨	221,149	250,997	272,088	414,575	367,330
採權益法之投資	27,642	29,617	149,040	314,883	618,063
不動產、廠房設備	2,693,837	3,064,475	3,234,980	2,544,204	2,353,081
負債總計	2,004,290	2,049,108	2,368,362	3,829,973	4,753,546
流動負債	944,227	913,583	1,264,525	1,673,297	1,487,005
應付帳款及票據	56,522	57,293	74,227	92,312	112,676
非流動負債	1,060,063	1,135,525	1,103,837	2,121,657	3,211,158
權益總計	2,960,489	3,483,263	4,323,576	5,404,998	6,673,063
普通股股本	259,304	259,321	259,327	259,327	259,327
保留盈餘	2,637,525	3,158,031	3,917,252	5,079,766	6,347,831
母公司業主權益	2,945,653	3,458,914	4,288,545	5,381,478	6,649,543
負債及權益總計	4,964,779	5,532,371	6,691,938	9,234,972	11,426,609

現金流量表

(百萬元)	2022	2023	2024F	2025F	2026F
營業活動現金	1,610,599	1,241,967	1,826,177	2,599,554	2,740,036
稅前純益	1,144,191	979,171	1,405,839	1,791,914	1,936,843
折舊及攤銷	437,254	532,191	662,753	710,733	852,414
營運資金變動	-53,286	324	-188,277	-98,366	-16,412
其他營運現金	82,440	-269,719	310,909	195,273	-32,808
投資活動現金	-1,190,928	-906,121	-864,843	-2,131,994	-3,628,272
資本支出淨額	-1,081,689	-949,113	-956,007	-1,280,000	-1,066,702
長期投資變動	-130,522	-55,850	-63,061	-61,258	-61,258
其他投資現金	21,283	98,842	-1,561,840	-790,736	-2,500,311
籌資活動現金	-200,244	-204,894	-346,301	287,143	604,575
長借/公司債變動	195,983	68,204	868,175	117,956	1,089,500
現金增資	0	0	0	0	0
發放現金股利	-285,234	-291,722	-363,055	-388,981	-414,924
其他籌資現金	-110,992	18,623	174,709	558,168	-70,002
淨現金流量	277,824	122,614	662,199	754,703	-283,661
期初現金	1,064,990	1,342,814	1,465,428	1,755,579	2,510,282
期末現金	1,342,814	1,465,428	2,127,627	2,510,282	2,226,621

資料來源：CMoney、群益

損益表

(百萬元)	2022	2023	2024F	2025F	2026F
營業收入淨額	2,263,891	2,161,736	2,894,309	3,719,753	4,108,621
營業成本	915,536	986,625	1,269,953	1,577,957	1,776,981
營業毛利淨額	1,348,355	1,175,111	1,624,355	2,141,796	2,331,640
營業費用	226,708	253,834	301,398	411,033	454,003
營業利益	1,121,279	921,466	1,322,053	1,730,763	1,877,637
EBITDA	1,570,773	1,463,068	2,068,635	2,491,914	2,788,843
業外收入及支出	542	-2,552	83,785	61,152	59,206
稅前純益	1,144,191	979,171	1,405,839	1,791,914	1,936,843
所得稅	127,290	141,404	233,407	290,581	253,854
稅後純益	1,016,530	838,498	1,173,268	1,501,334	1,682,989
稅後 EPS(元)	39.20	32.33	45.24	57.89	64.90
完全稀釋 EPS**	39.20	32.33	45.24	57.89	64.90

註1：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主。

註2：稅後 EPS 以股本 2,593.27【最新股本】億元計算

註3：完全稀釋 EPS 以股本 2,593.27 億元計算

比率分析

(百萬元)	2022	2023	2024F	2025F	2026F
成長力分析(%)					
營業收入淨額	42.61%	-4.51%	33.89%	28.52%	10.45%
營業毛利淨額	64.53%	-12.85%	38.23%	31.86%	8.86%
營業利益	72.51%	-17.82%	43.47%	30.91%	8.49%
稅後純益	70.40%	-17.51%	39.93%	27.96%	12.10%
獲利能力分析(%)					
毛利率	59.56%	54.36%	56.12%	57.58%	56.75%
EBITDA(%)	69.38%	67.68%	71.47%	66.99%	67.88%
營益率	49.53%	42.63%	45.68%	46.53%	45.70%
稅後純益率	44.90%	38.79%	40.54%	40.36%	40.96%
總資產報酬率	20.47%	15.16%	15.57%	16.26%	14.73%
股東權益報酬率	34.34%	24.07%	27.33%	27.78%	25.22%
償債能力檢視					
負債比率(%)	40.37%	37.04%	43.04%	41.47%	41.60%
負債/淨值比(%)	67.70%	58.83%	75.55%	70.86%	71.23%
流動比率(%)	217.42%	240.16%	219.96%	225.85%	225.85%
其他比率分析					
存貨天數	82.58	87.33	80.00	83.30	80.30
應收帳款天數	34.63	36.58	35.93	35.72	35.72

季度損益表

(百萬元)	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24F	1Q25F	2Q25F	3Q25F	4Q25F	1Q26F	2Q26F
營業收入淨額	546,733	625,529	592,644	673,510	759,692	868,462	842,549	903,936	960,624	1,012,644	938,739	966,220
營業成本	250,090	293,761	278,139	315,386	320,346	356,082	352,708	382,158	408,823	434,269	412,562	419,822
營業毛利淨額	296,642	331,768	314,505	358,124	439,346	512,380	489,841	521,778	551,802	578,375	526,177	546,399
營業費用	68,709	71,621	65,357	70,295	79,079	86,667	93,102	99,885	106,149	111,897	103,731	106,767
營業利益	228,065	260,205	249,018	286,556	360,766	425,713	396,739	421,893	445,653	466,478	422,447	439,631
業外收入及支出	13,876	18,076	17,525	19,755	23,421	23,085	13,037	13,977	16,061	18,076	13,037	13,717
稅前純益	241,940	278,281	266,543	306,311	384,187	448,798	409,776	435,870	461,714	484,554	435,484	453,348
所得稅	31,145	39,975	41,322	58,649	59,107	74,329	61,466	87,174	69,257	72,683	47,903	90,670
稅後純益	211,000	238,712	225,485	247,846	325,258	374,680	348,310	348,696	392,457	411,871	387,580	362,678
最新股本	259,327	259,327	259,327	259,327	259,327	259,327	259,327	259,327	259,327	259,327	259,327	259,327
稅後EPS(元)	8.14	9.21	8.70	9.56	12.54	14.45	13.43	13.45	15.13	15.88	14.95	13.99
獲利能力(%)												
毛利率(%)	54.26%	53.04%	53.07%	53.17%	57.83%	59.00%	58.14%	57.72%	57.44%	57.12%	56.05%	56.55%
營業利益率(%)	41.71%	41.60%	42.02%	42.55%	47.49%	49.02%	47.09%	46.67%	46.39%	46.07%	45.00%	45.50%
稅後純益率(%)	38.59%	38.16%	38.05%	36.80%	42.81%	43.14%	41.34%	38.58%	40.85%	40.67%	41.29%	37.54%
QoQ(%)												
營業收入淨額	13.70%	14.41%	-5.26%	13.64%	12.80%	14.32%	-2.98%	7.29%	6.27%	5.42%	-7.30%	2.93%
營業利益	12.93%	14.09%	-4.30%	15.07%	25.90%	18.00%	-6.81%	6.34%	5.63%	4.67%	-9.44%	4.07%
稅前純益	12.70%	15.02%	-4.22%	14.92%	25.42%	16.82%	-8.69%	6.37%	5.93%	4.95%	-10.13%	4.10%
稅後純益	16.06%	13.13%	-5.54%	9.92%	31.23%	15.19%	-7.04%	0.11%	12.55%	4.95%	-5.90%	-6.42%
YoY(%)												
營業收入淨額	-10.83%	0.00%	16.52%	40.07%	38.95%	38.84%	42.17%	34.21%	26.45%	16.60%	11.42%	6.89%
營業利益	-26.51%	-19.95%	7.69%	41.89%	58.19%	63.61%	59.32%	47.23%	23.53%	9.58%	6.48%	4.20%
稅前純益	-23.60%	-16.85%	9.12%	42.69%	58.79%	61.28%	53.74%	42.30%	20.18%	7.97%	6.27%	4.01%
稅後純益	-24.88%	-19.33%	8.94%	36.33%	54.15%	56.96%	54.47%	40.69%	20.66%	9.93%	11.27%	4.01%

註1：稅後EPS以股本2,593.27億元計算

註2：自2013年開始，稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主。

【投資評等說明】

評等	定義
強力買進(Strong Buy)	首次評等潛在上漲空間 $\geq 35\%$
買進(Buy)	$15\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 35\%$
區間操作(Trading Buy)	$5\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 15\%$
	無法由基本面給予投資評等
中立(Neutral)	預期近期股價將處於盤整 建議降低持股

【投資評等調整機制】

投資評等係「首次」給予特定個股投資評等時，其前一日收盤價相較 3 個月目標價之潛在上漲空間計算而得。個股投資評等分為四個等級，定義如上。爾後的投資評等係依循「首次評等」，直到停止推薦。

「強力買進」、「買進」及「區間操作」均有 upside 目標價。差別僅在於，首次評等時潛在報酬率不同。「中立」則無目標價。

一旦我們給予特定個股「強力買進」、「買進」或「區間操作」之投資評等，就是責任的開始，爾後將透過各式研究報告作定期性、持續性追蹤基本面及股價變化，直到停止推薦。

停止推薦情境：

1. 達目標價。
2. 雖未達原訂目標價，但檢視基本面、訊息面、籌碼面等多方訊息，研判股價上漲空間已然有限，將適時出具降評報告。
3. 推薦後股價不漲反跌，亦將出具降評報告。

【免責聲明】

本研究報告僅提供予特定人之客戶作為參考資料「非經同意不得轉載」。我們並不確保此資訊的完整性與正確性，投資人應了解，報告中有關未來預測之陳述可能不會實現，因而不應被依賴。而且此報告並非根據特定投資目的或依預定對象之財務狀況所撰寫出來的，因此，此研究報告的目的，既非對投資人於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關之衍生性商品提供詢價服務，亦非作為進行交易的要約。投資人應注意到相關證券之價值及收益，可能會有無預警地上升或下降，產生投資回報金額可能比原始投資來得少的情形。